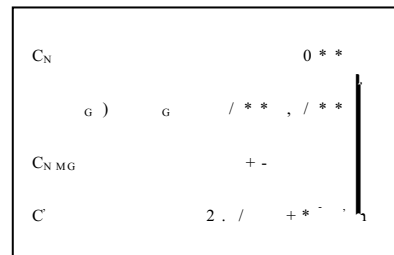


特点

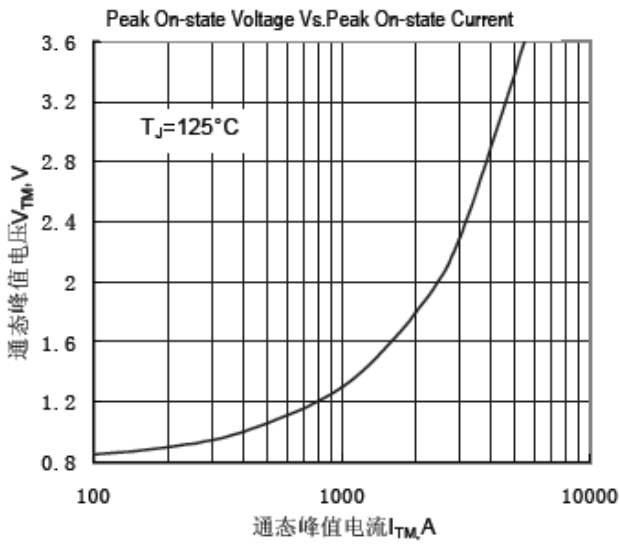
- 芯片与底板电气绝缘，交流电压
- 国际标准封装：全压接结构，优良的温度特性和功率循环能力
- 以下模块皆为强迫风冷，以上模块，风冷，水冷先用

典型应用

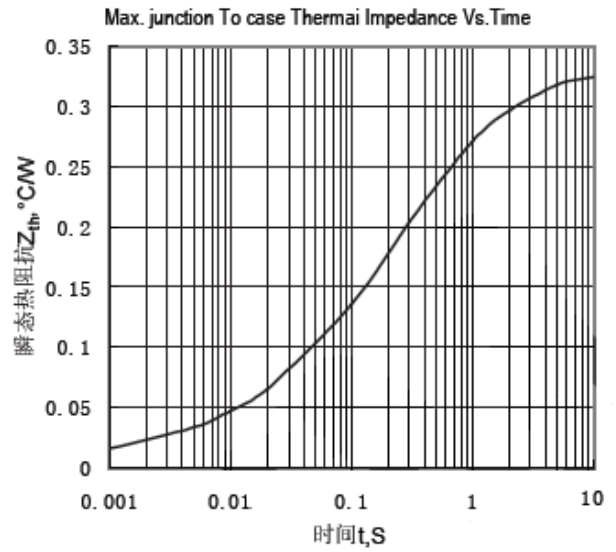
- 交直流电机控制，各种整流电源
- 工业加热控制，调光，无触发点开关
- 电机软起动，静止无功补偿
- 电焊机，变频器，电源，电池充放电



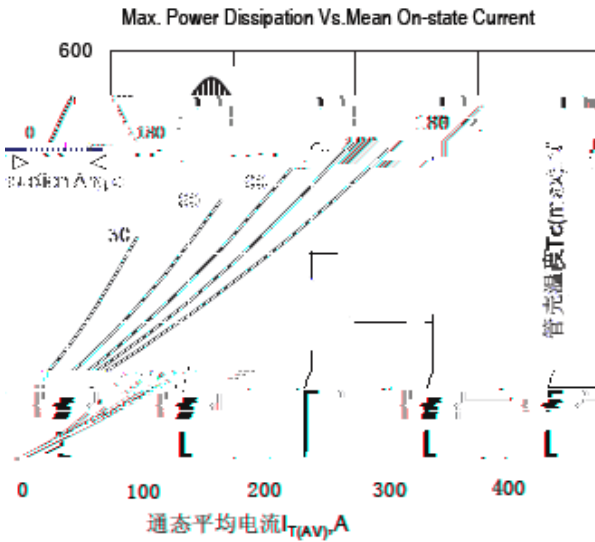
| 符号 | 参数 | 测试条件 | 结温 N _D °C | 参数值 | | | 单位 |
|----------------------------------|----------------------|---|-------------------------|--------|----|----------|-----------|
| | | | | 最小 | 典型 | 最大 | |
| C _N | 通态平均电流 | +2*° 正弦半波, I _T 双面散热, N = 72 / °C | +, / | | | 0** | |
| C _{N G M} | 方均根电流 | | +, / | | | 3, .. | |
| G G | 断态重复峰值电压 反向重复峰值电压 | G G j 7 + * g MG MG 7 G G , ** | +, / | / ** | | , / ** | |
| C _G C _G | 断态重复峰值电流 反向重复峰值电流 | G 7 G G 7 G | +, / | | | . * | g |
| C _{NMG} | 通态不重复浪涌电流 | + * g 底宽, 正弦半波 | +, / | | | + - (* | |
| C' | 浪涌电流平方时间积 | 7 * (0 G | +, / | | | 2. / | . M + * - |
| N I | 门槛电压 | | +, / | | | * (2 * | |
| I _N | 斜率电阻 | | +, / | | | * (/ - | g Ω |
| N G | 通态峰值电压 | C _{N G} 7 + 2 ** | , / | | | + (- / | |
|) | 断态电压临界上升率 | G 7 * (0 1 G | +, / | | | 2 ** |) |
| c) | 通态电流临界上升率 | C _{G N} 7 / , 门极触发电流幅值 C _A 7 + (/) 门极电流上 ≤ 升时间 t _i ≤ * (/) | +, / | | | + ** |) |
| C _{A N} | 门极触发电流 | | | - * | | , ** | g |
| A N | 门极触发电压 | 7 + , & C 7 + | , / | + (* | | - (* | |
| C | 维持电流 | | | , * | | , ** | g |
| A | 门极不触发电压 | G 7 * (0 1 G | +, / | * (, | | | |
| d | 热阻抗 (结至壳) | +2*° 正弦波, 单面散热 | | | | * (* 1 - | °C) |
| | 热阻抗 (壳至散) | +2*° 正弦波, 单面散热 | | | | * (* 1 - | °C) |
| c _h | 绝缘电压 | | | , / ** | | | |
| P | 安装扭矩 (G / | | | | +, | | H g |
| | 安装扭矩 (G 0 | | | | 0 | | H g |
| N | 储存温度 | | | . * | | +, / | °C |
| | 质量 | | | | | | a |
| I ch | 外形 | | | | | | |



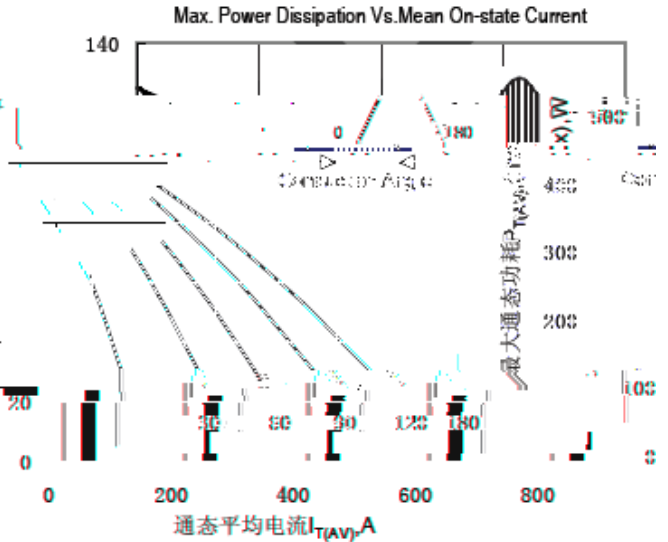
通态伏安特性曲线



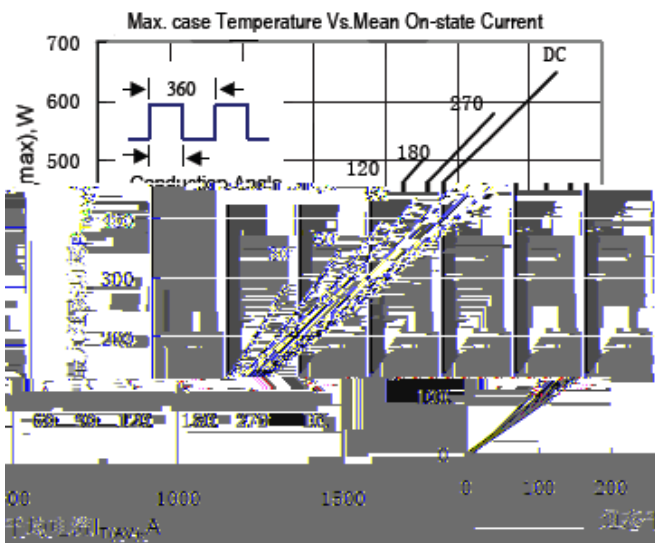
结至管壳瞬态热阻抗曲线



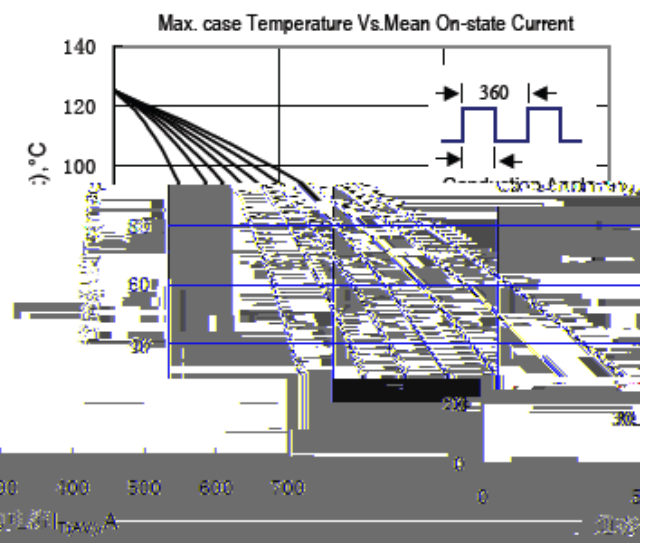
最大功耗与平均电流关系曲线



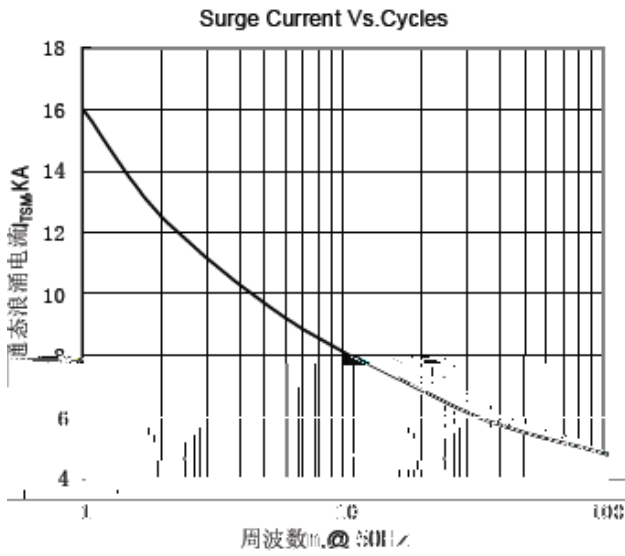
管壳温度与通态平均电流关系曲线



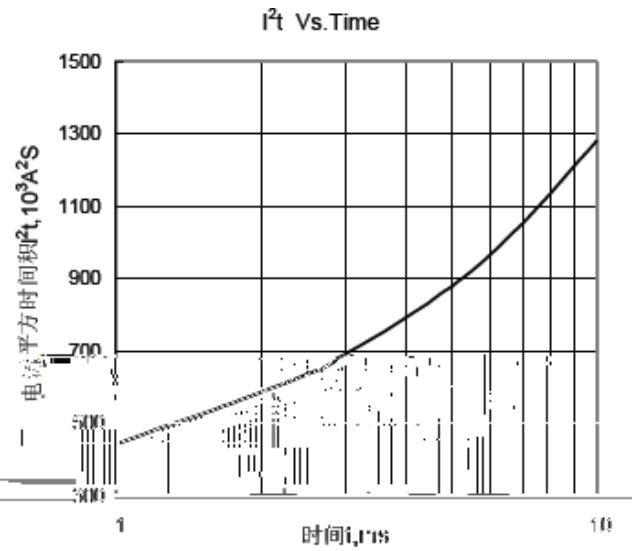
最大功耗与平均电流关系曲线



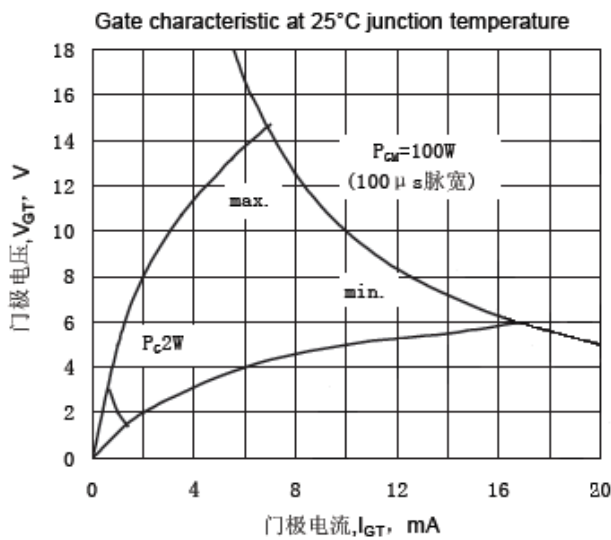
管壳温度与通态平均电流关系曲线



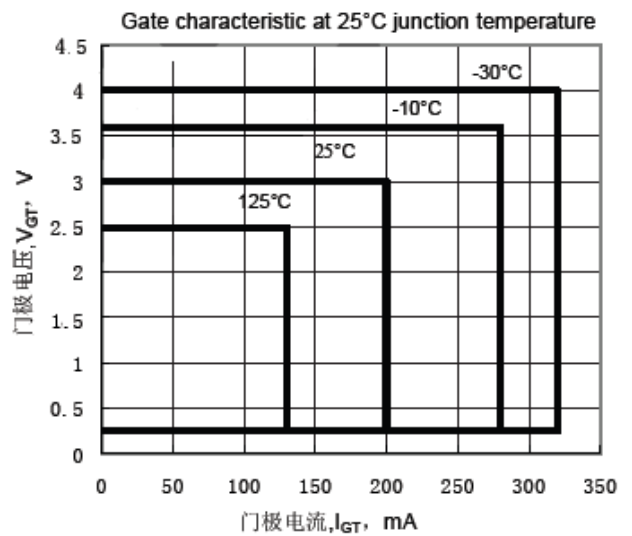
通态浪涌电流与周波数的关系曲线



特性曲线



门极功率曲线



门极触发特性曲线

外形图:

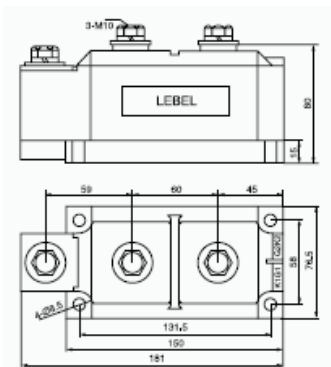
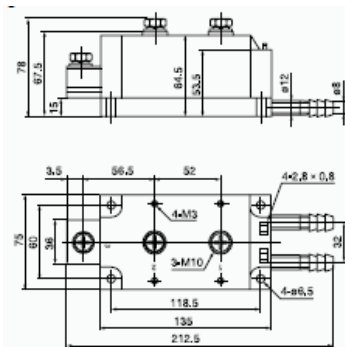


图 +



图

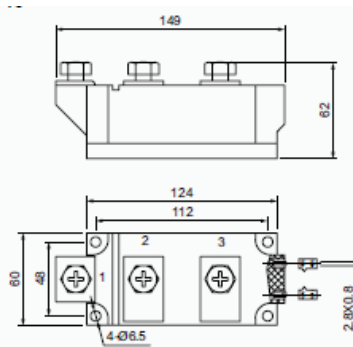
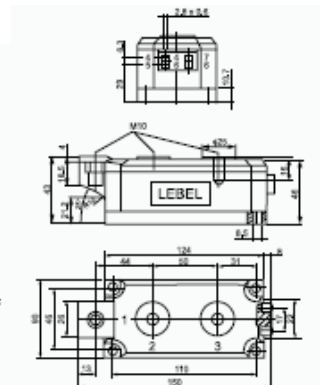


图 -



图

路图：

